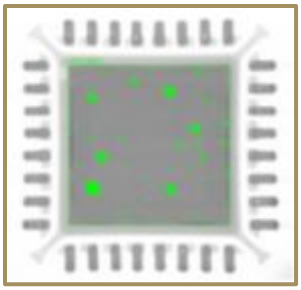
Solder plus Support

H10 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN CERO HALÓGENOS

ZERO HALOGEN HALIDE



CARACTERÍSTICAS

- Cero Halógenos /Haluros
- Excelente humectación
- Bajo nivel de vacíos en BTC y BGA
- Alta Confiabilidad
- Capacidad de impresión con una relación de área de 0.50 con T4
- Disponible en tamaño de polvo T4 y T5
- Disponible en SAC305, SN100C®, REL22™ y REL61™

DESCRIPCIÓN

H10 Zero Halogen No Clean Solder Paste fue desarrollada para ser una pasta de alto rendimiento con una fuerte actividad que deja residuos mínimos de alto valor SIR. H10 es capaz de lograr una eficiencia de transferencia >90% en relaciones de área de 0.50 en T4. El rendimiento de humectación de H10 elimina los defectos NWO (HiP) y mejora la cobertura del tampón en todos los acabados superficiales. AIM H10 reduce el vacío en BGA, BTC y LGA y mejora la confiabilidad electroquímica en todos los dispositivos de baja separación (stand-off).

CARACTERÍSTICAS

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PARAMETRO	TIEMPO	TEMPERATURA
Vida útil sellado y refrigerado	6 meses*	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil sellado sin refrigerar	3 meses*	< 25°C (< 77°F)

* Tamaño de polvo T4. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la vida útil de T5.

No añada pasta usada a la pasta sin usar. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta sin usar bien sellada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Una vez abierta, la vida útil de la pasta de soldar depende del entorno y de la aplicación. Consulte las guías de manejo de las pastas de AIM para más información. Las condiciones de aleación y almacenamiento pueden afectar a la vida útil. Consulte el certificado de análisis H10 para obtener información específica del producto.

LIMPIEZA

Pre-Reflujo: AIM DJAW-10 elimina eficazmente la pasta de soldadura H10 de los esténciles durante el proceso. DJAW-10 puede ser aplicado a mano o utilizado en equipos de limpieza bajo el esténcil. DJAW-10 no secará H10 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 en la parte superior del esténcil. Isopropanol (IPA) no es recomendado en el proceso pero puede ser utilizado como enjuague final del esténcil.

Residuos de flux post-reflujo: Los residuos de H10 pueden permanecer en el ensamblaje después del reflujo y no requieren limpieza. En los casos en que la limpieza es obligatoria, AIM ha trabajado estrechamente con socios de la industria para garantizar que los residuos de H10 puedan eliminarse eficazmente con agentes comunes de eliminación de flux. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre compatibilidad de limpieza.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

PERFIL DE REFLUJO

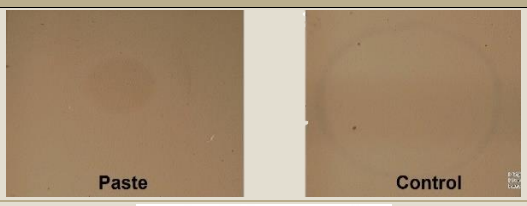
Se puede hallar información de perfil detallada en http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements . Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

IMPRESIÓN

AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS - DEPENDERÁN DEL DISEÑO DE LA PCB Y DEL PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Espátula	0.5 – 1.0kg/25mm
Velocidad de la Espátula	13 – 152 mm/segundos
Distancia de Desprendimiento	On Contact 0.00 mm
Distancia de Separación de la PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separación de la PCB	3 - 20 mm/segundos

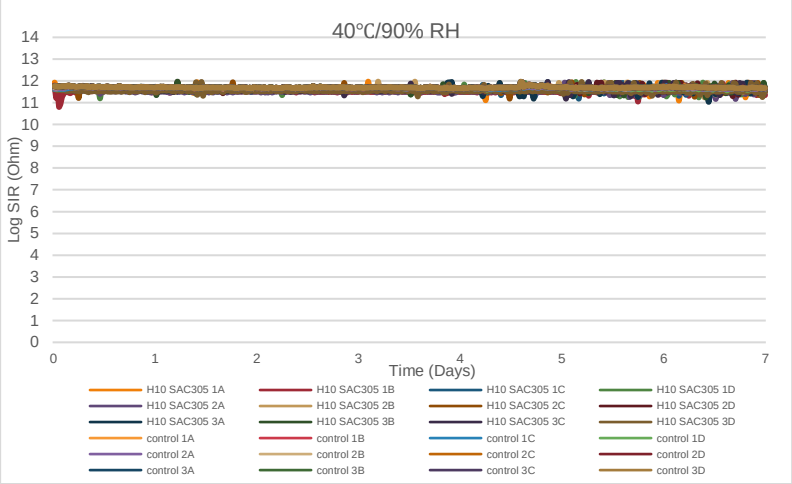
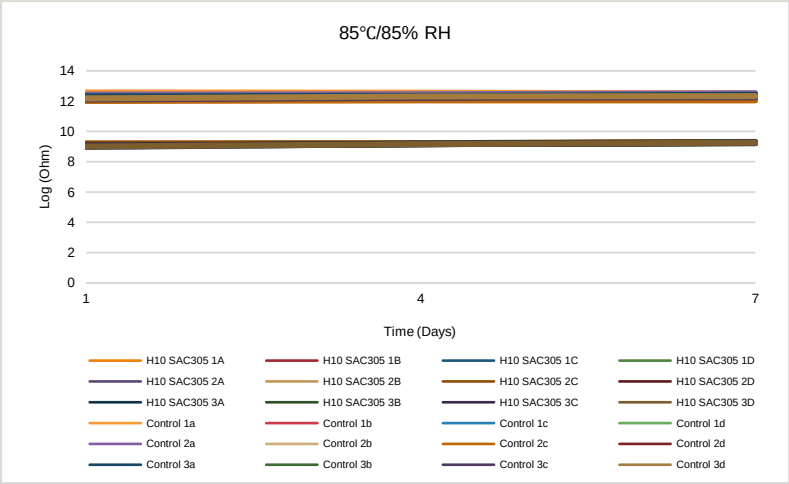
DATOS DE PRUEBAS

Nota: Todas las pruebas son para formulaciones T4 SAC305

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 Actual B, C	ROL0	
NOMBRE	**MÉTODO DE PRUEBA**	**RESULTADOS TÍPICOS**	**IMAGEN**
Espejo de Cobre	J-STD-004 Actual 3.3.1.1 IPC-TM-650 2.3.32 JIS Z 3197:2012 8.4.2	No avance Baja actividad	
Corrosión	J-STD-004 Actual 3.3.1.2 IPC-TM-650 2.6.15 JIS Z 3197:2012 8.4.1	No Corrosión Bajo	
Haluros cuantitativos	J-STD-004 Actual 3.3.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	<0.05% Bajo	Cl^- = 0ppm | Br^- = 0ppm | F^- = 0ppm | I^- = 0ppm
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004 Actual 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.33 JIS Z 3197:2012 8.1.4.2.4	PASA	
Haluros Cualitativos, Fluoruro Spot	J-STD-004 Actual 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	
Contenido de halógenos	J-STD-004 Actual 3.4.4 IPC-TM-650 2.3.28.1 EN 14582	PASA	Libre de Halógenos

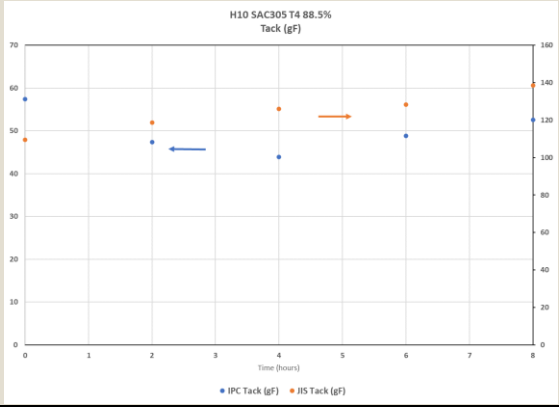
*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS	IMAGEN
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004 Actual 3.3.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	Estado No-clean ≥ 100 MΩ Bajo	
Resistencia de aislamiento superficial	J-STD-004 Actual 3.2.4.5 IPC-TM-650 2.6.3.3b	PASA	
Resistencia a la Electromigración	BELLCORE GR-78-CORE Issue 2 2007 13.2.7	PASA	
Flux Sólidos, Determinación No Volátil	J-STD-004 Actual 3.3.2.1 Rev 3.3.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	74% Contenido en sólidos	
Valor acido	J-STD-004 Current Rev. TM-650 2.3.13	174.2 mg KOH/g	
Viscosidad (Malcom)	J-STD-005 Actual 3.5.1 Rev A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	150-250 Típico (SAC305 T4)	
Visual	J-STD-004 Actual 3.3.2.5 Rev 3.3.2.5	PASA	
Desprendimiento (Slump)	J-STD-005 Actual 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.

Tack value	JIS Z 3284 2.4.44 IPC-TM-650		

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a http://www.aimsolder.com/terms-conditions para revisar términos y condiciones de AIM.